## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07225327 A

(43) Date of publication of application: 22.08.95

(51) Int. CI

G02B 6/42

H04B 10/14

H04B 10/135

H04B 10/13

H04B 10/12

(21) Application number: 06018566

(71) Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22) Date of filing: 15.02.94

(72) Inventor:

AKITA OSAMU

NAKANISHI HIROMI

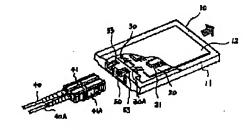
## (54) CARD TYPE OPTICAL DATA LINK

# (57) Abstract:

PURPOSE: To provide the card type optical data link which suppresses an increase in component cost and omits or decreases manufacture processes.

CONSTITUTION: The card type data link is equipped with a wiring board 20 which is incorporated in a housing 10 and processes an electric signal, an optical module 30 for transmission, an optical module 30A for reception, an optical connector 50 which is put in the fitting hole of the housing 10 and stores the optical module 30 for transmission and optical module 30A for reception, an optical connector plug 41 for transmission, and an optical connector plug 41A for reception. Then a couple of cuts 53 are formed in the top surface of the optical connector 50 in the front-rear direction and shielded and covered with an upper metallic panel 12 for reinforcement, and the overall thickness of the optical connector 50 is set to ≤5mm.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-225327

(43)公開日 平成7年(1995)8月22日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 6/42 H 0 4 B 10/14

10/135 10/13

9372-5K

H04B 9/00

Q

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 10 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平6-18566

(71)出顧人 000002130

住友電気工業株式会社

(22)出願日

平成6年(1994)2月15日

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72) 発明者 秋田 治

大阪府大阪市此花区島屋一丁目1番3号

住友電気工業株式会社大阪製作所内

(72)発明者 中西 裕美

大阪府大阪市此花区島屋一丁目1番3号

住友電気工業株式会社大阪製作所内

(74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (外4名)

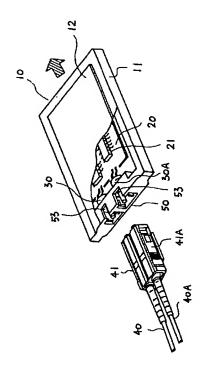
# (54) 【発明の名称】 カード型光データリンク

# (57)【要約】

(修正有)

【目的】 部品コストの抑制、及び製造工程の省略・削減等を図り得るカード型光データリンクを提供する。

【構成】 筐体10に内蔵され電気信号を処理する配線 板20と、送信用光モジュール30と、受信用光モジュール30と、受信用光モジュール30Aと、筐体10の取付孔に内蔵され送信用光モジュール30と受信用光モジュール30Aを収納する光コネクタ50と、送信用光コネクタブラグ41と、受信用光コネクタブラグ41Aとを備える。そして、光コネクタ50の上面に、切り欠き53を前後方向に向けそれぞれ切り欠くとともに、この一対の切り欠き53を上位の金属パネル12に隠蔽・被覆させて補強し、光コネクタ50の全体の厚さを5mm以内にする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 カードフレームとパネルからほぼカード 型に構成され光通信実現可能手段に使用される筐体と、 との筐体に内蔵され電気信号を処理する電気信号処理手 段と、この電気信号処理手段で変換された電気信号を光 信号に変換して送信用光ファイバで伝送する送信用光モ ジュールと、受信用光ファイバで伝送されてきた光信号 を電気信号に変換して該電気信号処理手段に出力する受 信用光モジュールと、該筐体の取付孔に設けられ送信用 光モジュールと受信用光モジュールを収納する光コネク 10 タと、この光コネクタに嵌入され該送信用光ファイバと 送信用光モジュールを接続する送信用光コネクタプラグ と、該光コネクタに嵌入され受信用光ファイバと受信用 光モジュールを接続する受信用光コネクタブラグとを備 え、該バネルに覆われる光コネクタの被覆面に、当該光 コネクタの厚みを薄くする複数の切り欠きを切り欠いた ことを特徴とするカード型光データリンク。

【請求項2】 上記送信用光コネクタブラグと受信用光 コネクタプラグは、厚さが5mm以下のMU型の光コネ クタプラグからなることを特徴とする請求項1記載のカ 20 ード型光データリンク。

【請求項3】 上記筐体と該光コネクタをエンジニアリ ングプラスチックで一体成形して構成することを特徴と する請求項1記載のカード型光データリンク。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、コンピュータ、電子機 器、又は、測定機器等を用いた光通信でデータを送受信 する際に使用されるカード型光データリンクに関するも のである。

## [0002]

【従来の技術】従来における光データリンクは、図13 に示す如く、レセプタクル7の内部に、パッケージ8、 複数の電子回路基板20、送信用光モジュール30及び 受信用光モジュール30Aをそれぞれ配設するようにし

【0003】上記レセプタクル7は、同図に示す如く、 ほぼ箱構造に構成され、その内部には、ほぼ枠形のリー ドフレーム (図示せず) がほぼ水平に配設されており、 レセプタクル7は、その前部に、短辺方向に指向する溝 孔 (図示せず) が貫通して穿設され、背面には、被接続 作用を営むFDDI型の一対の光コネクタアダプタが並 べて設けられている。この一対の光コネクタアダプタ は、図示しないが、各々がほぼボックス形の角筒形に構 成され、それぞれ5mm以上の厚さを有している。然し て、この一対の光コネクタアダプタが5mm以上の厚み を有しているので、レセプタクル7も、必然的に5m m、又は、10mm以上の厚さ(高さ)のほぼ箱構造に 構成されることとなる。尚、一対の光コネクタアダブタ 50 こととなる。尚、この受信用光コネクタプラグにも、F

には、上述したFDDI型の他に、周知のSC型、FC 型及びST型のタイプがある。

【0004】また、上記したパッケージ8は、図13に 示す如く、 横一列に整列した複数のリードピン8 a を備 え、レセプタクル7の内部前方に内蔵されており、電気 的接続部を構成する複数のリードピン8aがレセプタク ル7から外部下方に露出した状態で突出している。

【0005】そして、上記複数の電子回路基板20は、 同図に示す如く、リードフレームの前方における複数の アイランド部にそれぞれ配設され、電気信号をそれぞれ 処理する機能を有している。

【0006】一方、上記した送信用光モジュール30 は、同図に示す如く、縮径の末端部が開口したほぼ凸字 形の円筒形に構成されるとともに、その前面には、電子 回路基板20と電気的に接続する一対のリードピン(図 示せず) が挿着され、リードフレームの内部後方に水平 状態で支持されており、電子回路基板20から出力され た電気信号を光信号に変換して送信用光ファイバで外部 に伝送する機能を有している。との送信用光ファイバ は、図示しないが、その外周面が保護作用を営む被覆層 (図示せず) に被覆され、先端部には、光コネクタアダ ブタと嵌合する送信用光コネクタプラグが嵌着されてい る。そして、送信用光ファイバの最先端部には、送信用 光モジュールのスリーブの内部に挿入されるフェルール が嵌着され、このフェルールが、軸ずれ等を防止する作 用を営む。然して、送信用光ファイバの送信用光コネク タプラグは、光コネクタアダプタと嵌合・接続するとい **う機能上、細長いほぼボックス形の角筒形に構成され、** しかも、必然的に5mm以上の厚さで構成されている。 30 尚、この送信用光コネクタプラグにも、FDDI型、S C型、FC型及びST型のタイプがある。

【0007】さらに、上記受信用光モジュール30A は、図13に示す如く、縮径の末端部が開口したほぼ凸 字形の円筒形に構成されるとともに、その前面には、電 子回路基板20と電気的に接続する一対のリードピン (図示せず) が挿着され、リードフレームの内部後方に 送信用光モジュール30と隣接状態で支持されており、 受信用光ファイバで伝送されてきた光信号を電気信号に 変換して配線板に出力する機能を有している。この受信 図示しない基板上に実装されるようになっている。との 40 用光ファイバも、図示しないが、その外周面が保護作用 を営む被覆層(図示せず)に被覆され、先端部には、光 コネクタアダプタと嵌合する受信用光コネクタブラグが 嵌着されている。そして、受信用光ファイバの最先端部 には、受信用光モジュール30Aのスリーブの内部に挿 入されるフェルールが嵌着され、このフェルールが、軸 ずれ等を防止する作用を営む。然して、受信用光ファイ バの受信用光コネクタブラグも、光コネクタアダプタと 嵌合・接続するという機能上、細長いほぼボックス形の 角筒形に構成され、必然的に5mm以上の厚さを有する

DDI型、SC型、FC型及びST型のタイプがある。 【0008】従って、電子回路基板20から送信用光モ ジュール30に電気信号が出力されると、送信用光モジ ュール30が電気信号を光信号に変換し、この光信号が 送信用光モジュール30から外部に送信用光ファイバで 伝送される。とれに対し、受信用光ファイバから受信用 光モジュール30Aに光信号が伝送されてくると、受信 用光ファイバが光信号を電気信号に変換し、この電気信 号が受信用光モジュール30Aから電子回路基板20に 出力されることとなる。

【0009】ところで、近年、ノート型のパソコン等の データを記憶 (メモリー) したり、或いは、FAXで伝 送したりして、電気的なネットワークを形成して情報処 理をパーソナル化することが急激に普及し、且つ、広ま っている。この急激な普及と広がりには、種々の理由が あるが、その一つとして、通信用カードの標準化が挙げ られる。即ち、上記電気的なネットワークの形成に際し ては、PCカード形の通信用カードが使用されるが、C の通信用カードの規格はタイプーとタイプーーに分類さ ドは、その厚みが3.3mm以下、又は、5mm以下と それぞれ明確に規定(社団法人 日本電子工業振興協会 ガイドライン Ver.4.1参照)され、この明確 な規定に基づいて、情報媒体の標準化が効率的に推進さ れており、この結果、汎用性が著しく向上して、パソコ ン等の活用領域が大幅に拡大していることはもはや論を 待たないところである。

【0010】しかしながら、上記通信用カードは、確か に汎用性には優れているが、電気信号を出力できるに過 ぎず、光信号を全く出力することができなかったので、 パソコン等のPCカード用スロットを使用し、データを 光信号により送受信することが全く不可能だった。従っ て、パソコン等の既存のシステムを利用して光ネットワ ークを安価に形成・拡大し、高度情報化社会を建設する ことも同様に不可能な状況にあった。

【0011】そこで、パソコン等の既存のシステムを使 用して光通信によるデータの送受信を可能ならしめ、大 量のデータを迅速、且つ、容易に伝送し得る高度情報化 社会を建設するという構想に、大きな期待と関心が寄せ られている。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】以上の如く、パソコン 等の既存のシステムを使用した光通信によるデータの送 受信に大きな期待と関心が寄せられているが、この構想 の実現のためには、光データリンクを、上述したタイプ 1・11の通信用カードに準拠して構成し、パソコン等 のPCカード用スロットに挿着する必要がある。

【0013】然るに、従来の光データリンクは、該構想 を全く前提にしていなかったので、カード型ではなく、 5mm以上の厚さ(髙さ)のほぼ箱構造に構成されてい 50 図1に示す如く、筐体10の内部に、電子回路基板2

た。さらに、送信用光コネクタプラグ及び受信用光コネ クタプラグも、該構想を全く欠いていたので、5 mm以 上の厚さで必ず構成されていた。従って、パソコンのP Cカード用スロットに到底挿着することができないとい う大きな問題点があった。

【0014】本発明は上記に鑑みなされたもので、パソ コン等のPCカード用スロットを使用して光通信による データの送受信を可能ならしめ、しかも、部品コストの 抑制、及び製造工程の省略・削減等を図ることのできる 10 カード型光データリンクを提供することを目的としてい

## [0015]

【課題を解決するための手段】本発明においては上述の 目的を達成するため、カードフレームとパネルからほぼ カード型に構成され光通信実現可能手段に使用される筺 体と、との筐体に内蔵され電気信号を処理する電気信号 処理手段と、この電気信号処理手段で変換された電気信 号を光信号に変換して送信用光ファイバで伝送する送信 用光モジュールと、受信用光ファイバで伝送されてきた れている。これらのタイプ [・ | ] における通信用カー 20 光信号を電気信号に変換して該電気信号処理手段に出力 する受信用光モジュールと、該筐体の取付孔に設けられ 送信用光モジュールと受信用光モジュールを収納する光 コネクタと、この光コネクタに嵌入され該送信用光ファ イバと送信用光モジュールを接続する送信用光コネクタ プラグと、該光コネクタに嵌入され受信用光ファイバと 受信用光モジュールを接続する受信用光コネクタプラグ とを備え、該パネルに覆われる光コネクタの被覆面に、 当該光コネクタの厚みを薄くする複数の切り欠きを切り 欠くようにしている。

> 【0016】尚、本発明における上記送信用光コネクタ 30 ブラグと受信用光コネクタブラグは、厚さが5mm以下 のMU型の光コネクタプラグからなるものである。

【0017】また、本発明においては、上記筐体と該光 コネクタをエンジニアリングプラスチックで一体成形し て構成するようにしている。

#### [0018]

【作用】上記構成を有する本発明によれば、筐体が薄い カード型に構成され、しかも、光コネクタの被覆面の切 り欠きがパネルに覆われ、且つ、補強されるので、当該 40 光コネクタの厚みを5 mm以内にすることができ、光通 信実現可能手段に使用することが可能となり、これを通 じて、光通信でデータを送受信することができる。

【0019】また、本発明によれば、送信用光コネクタ プラグと受信用光コネクタブラグの厚みが4.4mmな ので、それぞれを光コネクタに嵌入することができる。 [0020]

【実施例】以下、図1乃至図10(a)、(b)、

- (c) に示す一実施例に基づき本発明を詳説する。
- 【0021】本発明に係るカード型光データリンクは、

0、送信用光モジュール30、受信用光モジュール30 A、及び光コネクタ50をそれぞれ配設し、光コネクタ 50にMU型の送信用光コネクタブラグ41を嵌入して 送信用光モジュール30と送信用光ファイバ40を接続 するとともに、光コネクタ50にMU型の受信用光コネ クタブラグ41Aを嵌入して受信用光モジュール30A と受信用光ファイバ40Aを接続するようにしている。 【0022】上記筐体10は、平面ほぼ長方形で小型の カードフレーム11の両開口表面に、金属パネル(パネ ル) 12がそれぞれ覆い設けられ、しかも、PCMCI A/JEIDAで規格されたタイプIIの通信用カード に準拠して薄く構成されている。カードフレーム11 は、図3(b)に示す如く、平面ほぼ長方形の枠体から なり、その一短辺の中央部には、隙間が形成されてお り、この隙間が取付孔13を形成している。また、カー ドフレーム11の他短辺は、その肉厚が薄く構成され、 後述する電気コネクタ22の複数のピンが突出するよう になっている。また、金属パネル12は、図2に示す如 く、金属から小型で薄い平面ほぼ長方形に形成され、カ ードフレーム11の両開口表面にそれぞれ覆い設けられ 20 るととにより、電子回路基板20、電気コネクタ22、 送信用光モジュール30、受信用光モジュール30A、 及び光コネクタ50等を外部から有効に隠蔽・被覆する とともに、電気的なシールド等の効果を発揮するように なっている。さらに、筐体10はPCMCIA/JEI DAで規格されたタイプIIの通信用カードに準拠して 薄く構成されるが、これは、(1)パソコン(図示せ ず)のPCカード用スロット等の既存のシステム、送信 用光コネクタプラグ41、及び受信用光コネクタプラグ 4 1 A等を有効に利用して光ネットワークを安価に形成 30 ・拡大する、(2)タイプ I・11の通信用カードの中 では、タイプIIの通信用カードのほうが少々肉厚なの で、加工性に優れている、という理由に基づくものであ る。然して、との筐体10は、タイプ!1の通信用カー ドに準拠して構成されるので、その長辺部が85.6± 0. 2, 短辺部が54.0±0.1, 接続部の厚さが 3. 3±0.1, そして基体部 (平坦部) の厚さが5. 0以下、且つ、 t (任意の寸法) ± 0.2のミリサイズ のカード型に構成されることとなる。

路基板20、電気コネクタ22、送信用光モジュール3 0、受信用光モジュール30A、及び光コネクタ50等 を外部から有効に隠蔽・被覆させるものを示すが、金属 パネル12に電子回路基板20、電気コネクタ22、送 信用光モジュール30、受信用光モジュール30A、又 は、光コネクタ50等の全部、若しくは、一部を外部か ら有効に隠蔽・被覆させても良いのは言うまでもない。 さらに、ほぼ同様の作用・機能を有するものであれば、 プラスチック等、他の材料でパネル12を形成するよう にしても良い。さらにまた、本実施例では筐体10をP

CMCIA/JEIDAで規格されたタイプIIの通信 用カードに準拠して薄板形に構成するものを示すが、適 宜、タイプ【や【【の通信用カードに準拠して薄く構成 しても上記実施例と同様の作用効果が期待できる。尚、 このタイプ【の通信用カードに準拠して薄く構成する場 合には、長辺部が85.6±0.2、短辺部が54.0 ±0.1,接続部の厚さが3.3±0.1,そして基体 部 (平坦部) の厚さが3.3±0.2のミリサイズのカ ード型に構成されるとととなる(この点につき、社団法 10 人 日本電子工業振興協会 ガイドライン Ver. 4.1参照)。

【0024】また、上記した配線板(電気信号処理手 段)20は、図3(b)に示す如く、平面ほぼ長方形に 薄く形成され、その表面には、複数のリードピンを備え たIC21が複数実装されており、筐体10の内部に内 蔵されている。カードフレーム11の他短辺側に位置す る電子回路基板20の端部には、PCMCIA/JEI DAで規格化された電気コネクタ22が取り付けられ、 との複数のピンを備えた電気コネクタ22が、パソコン (光通信実現可能手段)のPCカード用スロットに挿着 されるようになっている。然して、電子回路基板20 は、電気コネクタ22とPCカード用スロットの電気的 な挿着・接続に基づき、パソコン等との間の電気的な信 号を処理する機能を有している。

【0025】尚、本実施例では図3(b)の電子回路基 板20を示すが、ほぼ同様の作用・機能を有するもので あれば、何等との形状や構造に限定されるものではな い。さらに、本実施例では光通信実現可能手段として、 主にパソコンを示すが、光通信を実現することのできる 装置であれば、他のコンピュータ、ファクシミリ、測定 機械器具、理化学機械器具、電子応用機械器具、光学機 械器具、又は、電気通信機械器具等を使用しても良いの は明白である。

【0026】一方、上記送信用光モジュール30は、図 4に示す如く、ほぼ円形の素子パッケージ31の裏面 に、両端面が開口した断面ほぼ凸字形で円筒形を呈した スリーブ32の拡径部が取り付けられ、筐体10の内部 に内蔵されており、電子回路基板20から出力された電 気信号を光信号に変換して送信用光ファイバ40で外部 【0023】尚、本実施例では金属バネル12に電子回 40 に伝送する機能を有している。素子バッケージ31の表 面には、複数のリードピン33が挿着され、この複数の リードピン33がワイヤ(図示せず)を介して電子回路 基板20と電気的に接続されている。とれに対し、素子 パッケージ31の裏面の中心部には、同図に示す如く、 電気信号を光信号に変換するLED、又は、LD等の光 素子34が取り付けられるとともに、キヤップ35が取 り付けられ、このキヤップ35の中心部には、光素子3 4と送信用光ファイバ40のフェルール42を光学的に 結合させるレンズ36が嵌着されている。また、スリー 50 ブ32の縮径部の内周面には、図4に示す如く、送信用 光ファイバ40のフェルール42と精密に嵌合する精密 スリーブ37が髙精度に形成されるとともに、送信用光 ファイバ40のフェルール42に係止される係止部38 が突設されている。

【0027】尚、本実施例では図4の送信用光モジュー ル30を使用するものを示すが、同様の機能を営むもの であれば、何等との形状、構造、及び数に限定されるも のではない。また、図4に示すスリーブ32でなくとも 良く、例えば、長手方向にスリ割りの入った割りスリー ブ等を使用するようにしても良いのは明らかである。 【0028】また、上記送信用光ファイバ40は、図6 (a)、(b)に示す如く、その外周面が保護作用を営 む被覆層に被覆され、先端部には、接続作用を営むMU 型の送信用光コネクタプラグ41が嵌着されており、と のMU型の送信用光コネクタプラグ41の横には、MU 型の受信用光コネクタプラグ41Aが一体的に設けられ ている。送信用光ファイバ40の最先端部には、円筒形 のフェルール42が嵌着され、このフェルール42が、 精密スリーブ37に精密に挿入されて送信用光ファイバ 40の軸ずれ等を防止する作用を営む。さらに、MU型 20 の送信用光コネクタプラグ41は、従来のFDDI型、 SC型、FC型及びST型の送信用光コネクタプラグ4 1が5mm以上の厚さで構成されていたのに対し、4. 4mmの薄い厚さで構成されている。さらにまた、着脱 が自在のレセプタクルタイプに構成されるとともに、細 長いほぼボックス形の角筒形に構成され、操作性、高密 度実装性、小型、軽量、高性能、高信頼性、及び安価に 優れており、しかも、現在、急速に普及しつつある。以 上のことから明白なように、MU型の送信用光コネクタ プラグ41を使用するのは、4.4mmの厚さなので、 筐体10の光コネクタ50に嵌入しても、支障を来さな いという理由に基づくものである。

【0029】尚、本実施例では送信用光ファイバ40を 単に示すが、光を伝送する機能を有するものであれば、 いかなる種類の送信用光ファイバ40でも良い。さら に、MU型の送信用光コネクタブラグ41に必ずしも限 定されるものではなく、5 mm以下の厚さなら、他の種 類の送信用光コネクタブラグ41でも良い。

【0030】また、上記した受信用光モジュール30A 裏面に、両端面が開口した断面ほば凸字形で円筒形を呈 したスリーブ32の拡径部が取り付けられ、筐体10の 内部に内蔵されるとともに、隣接した送信用光モジュー ル30と相俟ってトランシーバー構造に構成されてお り、受信用光ファイバ40Aで外部から伝送されてきた 光信号を電気信号に変換して電子回路基板20に出力す る機能を有している。素子パッケージ31の表面には、 複数のリードピン33が挿着され、この複数のリードピ ン33がワイヤ(図示せず)を介して電子回路基板20

ジ31の裏面の中心部には、同図に示す如く、電気信号 を光信号に変換するPD等の光素子34が取り付けられ るとともに、キヤップ35が取り付けられ、このキヤッ プ35の中心部には、光素子34と受信用光ファイバ4 0Aのフェルール42を光学的に結合させるレンズ36 が嵌着されている。また、スリーブ32の縮径部の内周 面には、図4に示す如く、受信用光ファイバ40Aのフ ェルール42と精密に嵌合する精密スリーブ37が高精 度に形成されるとともに、受信用光ファイバ40Aのフ 10 ェルール42に係止される係止部38が突設されてい

【0031】尚、本実施例では図4の受信用光モジュー ル30Aを使用するものを示すが、同様の機能を営むも のであれば、何等との形状、構造及び数に限定されるも のではない。また、図4に示すスリーブ32でなくとも 良く、長手方向にスリ割りの入った割りスリーブ等を使 用するようにしても良いのは言うまでもない。

【0032】また、上記受信用光ファイバ40Aは、図 6(a)、(b) に示す如く、その外周面が保護作用を 営む被覆層に被覆され、先端部には、接続作用を営むM U型の受信用光コネクタプラグ41Aが嵌着されてお り、このMU型の受信用光コネクタブラグ41Aの横に は、MU型の送信用光コネクタプラグ41が一体的に設 けられている。受信用光ファイバ40Aの最先端部に は、円筒形のフェルール42が嵌着され、このフェルー ル42が、精密スリーブ37に精密に挿入されて受信用 光ファイバ40Aの軸ずれ等を防止する作用を営む。さ らに、MU型の受信用光コネクタブラグ41Aは、同図 に示す如く、FDDI型、SC型、FC型及びST型の 受信用光コネクタブラグが5mm以上の厚さで構成され ているのに対し、4.4mmの薄い厚さで構成されてい る。さらにまた、着脱が自在のレセプタクルタイプに構 成されるとともに、細長いほぼボックス形の角筒形に構 成され、操作性、高密度実装性、小型、軽量、高性能、 高信頼性、及び安価に優れており、しかも、現在、急速 に普及しつつある。尚、この受信用光ファイバ40Aと 送信用光ファイバ40の末端部も、上記とほぼ同様に処 理され、他の受信用光ファイバ40Aと送信用光ファイ バ40に接続されている。以上の記載から明白なよう は、図4に示す如く、ほぼ円形の素子パッケージ31の 40 に、MU型の受信用光コネクタブラグ41Aを使用する のは、言及するまでもなく、4. 4mmという厚さなの で、筐体10の光コネクタ50に嵌入しても、何等支障 を来さないという理由に基づくものである。

【0033】尚、本実施例では受信用光ファイバ40A を単に示すが、光を伝送する機能を有するものであれ は、いかなる種類の受信用光ファイバ40Aでも良い。 さらにまた、MU型の受信用光コネクタプラグ41Aに 必ずしも限定されるものではなく、5mm以下の厚さな ら、他の種類の受信用光コネクタプラグ4 1 Aでも良 と電気的に接続されている。これに対し、素子パッケー 50 く、又、図9(a)、(b)に示すように、送信用光コ

ネクタプラグ41と分離した単心構造でも上記実施例と 同様の作用効果が期待できる。

【0034】他方、上記した光コネクタ50は、図3 (a)、(b)や図5(a)、(b)に示す如く、エン ジニアリングプラスチック等から正面が開口したほぼ箱 構造に構成され、筐体10の取付孔13にブロック60 を介したほぼ埋没・隠蔽状態で嵌着されており、送信用 光モジュール30と受信用光モジュール30Aを並列状 態で収納するとともに、並列に並んだMU型の送信用光 コネクタプラグ41と受信用光コネクタプラグ41Aに 10 れ貫通されることとなる。 嵌入されるようになっている。この光コネクタ50の内 部中央には、図3(b)に示す如く、区画板51が一体 的に介在され、この区画板51が、光コネクタ50の内 部を2つのアダプタ空間に区画する作用を営む。また、 光コネクタ50の背面には、図示しない一対の丸孔が並 べて穿設され、との一対の丸孔が送信用光モジュール3 0と受信用光モジュール30Aのスリーブ32にそれぞ れ貫通されるようになっている。また、光コネクタ50 の内部には、図3(b)や図5(a)、(b)に示す如 く、正面方向に指向する一対の挟持片52が一体的に2 20 後方向に向けそれぞれ切り欠いても良いのは明白であ 組取り付けられ、との複数対の挟持片52が、送信用光 モジュール30と受信用光モジュール30Aの突出して きたスリーブ32をそれぞれ挟持して位置ずれや抜けを 防止する機能を有している。また、光コネクタ50の両 側面には、取り付け用の取付部がそれぞれ配設されてい る。そして、光コネクタ50の上面(被覆面)には、図 5 (a) に示す如く、切り欠き53が前後方向に向けそ れぞれ切り欠かれ、この一対の切り欠き53が、光コネ クタ50の厚みを薄くする機能を有している。

【0035】 この点について細説すると、既存のMU型 30 の光コネクタ50は、図7(a)に示す如く、嵌入時に MU型の送信用光コネクタブラグ41や受信用光コネク タプラグ4 1 Aを囲んで嵌合するようボックス型に構成 されるので、その上下面の厚み(強度を考慮した場合、 0. 3mm程度必要となる)や金属パネル12の厚みを 考慮すると、5 mm以内に設計することが極めて困難で ある。この困難性を数値に基づいて説明すれば、MU型 の送信用光コネクタブラグ41・受信用光コネクタブラ グ4 1 A の厚さ4. 4 mm+光コネクタ5 0 の下面5 0 さ0.3mm+-対の金属パネル12の厚さ0.15m  $m \times 2 = 5$ . 3 mmである。そこで、本発明では、この 点に鑑み、図7(b)に示す如く、光コネクタ50の上 面に、切り欠き53を前後方向に向けそれぞれ切り欠く とともに、この一対の切り欠き53を上位の金属パネル 12に隠蔽・被覆させて強固に補強し、光コネクタ50 の上面の厚さ0.3mmを0にし、光コネクタ50全体 の厚さを確実に5mm以内にするよう構成している。

【0036】然して、上記ブロック60は、図3(b)

10

凹字形に構成され、カードフレーム11の取付孔13に 図示しないピンや接着剤等で設けられており、その内部 には、光コネクタ50がレーザ溶接や接着剤等で嵌着さ れている。このブロック60の両側面には、取付けの際 に使用される取付部がそれぞれ配設されている。また、 光コネクタ50の背面に重合するブロック60の背面部 には、図5 (a)に示す如く、一対の丸孔61が並べて 穿設され、この一対の丸孔61が送信用光モジュール3 0と受信用光モジュール30Aのスリーブ32にそれぞ

【0037】尚、本実施例では図3(a)、(b)や図 5(a)、(b)の光コネクタ50を示すが、同様の作 用・機能を営むものであれば、図10(a)、(b)、 (c) に示すように、他の形状や構造の光コネクタ50 を使用しても良い。また、本実施例ではブロック60と 光コネクタ50を別々に構成したものを示すが、これら ブロック60と光コネクタ50を成形等により一体的に 構成しても、上記実施例と同様の作用効果を奏する。さ らにまた、光コネクタ50の下面に、切り欠き53を前

【0038】従って、パソコン等のPCカード用スロッ トを使用して光通信でデータを送信する場合には、光コ ネクタ50に、送信用光コネクタプラグ41と受信用光 コネクタプラグ41Aを嵌入し、PCカード用スロット に筐体10を挿着し、所定のキーを押圧操作すれば良 44

【0039】すると、電気信号がパソコンから電気コネ クタを経由して電子回路基板20に出力され、この電子 回路基板20が電気信号を処理し、この処理された電気 信号が送信用光モジュール30に出力される。そして、 この送信用光モジュール30の光素子34が電気信号を 光信号に変換し、この光信号が送信用光ファイバ40で 外部の他のパソコン等に伝送され、光通信でデータを送 信することができる。

【0040】とれに対し、光通信でデータを受信する場 合には、光信号が外部の他のパソコン等から受信用光フ ァイバ40Aを経由して受信用光モジュール30Aに伝 送され、この受信用光モジュール30Aの光素子34が aの厚さ0.3mm+光コネクタ50の上面50bの厚 40 光信号を電気信号に変換し、との変換された電気信号が 電子回路基板20に出力される。そして、との電子回路 基板20が電気信号を処理し、この処理された電気信号 が電気コネクタ22を経由してパソコンに出力され、光 通信でデータを受信することができる。

> 【0041】上記構成によれば、PCMCIA/JEI DAで規格されたタイプIIの通信用カードに準拠して 筐体10を薄く構成しているので、パソコン等のPCカ ード用スロットを容易に使用することができ、これを通 じて、光通信でデータを送受信することができる。ま

や図5 (a)に示す如く、金属やブラスチックからほぼ 50 た、光コネクタ5 0の上面に、切り欠き 5 3 を前後方向

に向けそれぞれ切り欠いているので、光コネクタ50の 厚みを著しく薄くすることができ、従って、光コネクタ 50の厚みを5mm以内にすることが可能となる。ま た、筐体10、光コネクタ50、送信用光コネクタプラ グ41及び受信用光コネクタブラグ41Aを一体的に構 成できるので、別々の部品を組み立てる場合に比べ、凹 凸部分の減少、部品点数の削減、部品の寸法精度の緩 和、及び組み立て作業性の向上を図ることができる。さ らに、今後必要となる高速光LANに容易に使用でき、 使用した場合には著しい効果が期待できる。また、カー 10 ドフレーム11の両開口表面に金属パネル12をそれぞ れ覆い設けるので、電子回路基板20、電気コネクタ2 2、送信用光モジュール30、受信用光モジュール30 A、及び光コネクタ50等を外部から有効に隠蔽・被覆 することができ、さらに、電気的なシールド効果も期待 できる。また、送信用光モジュール30と受信用光モジ ュール30Aのスリーブ32に、精密スリーブ37をそ れぞれ形成しているので、光学的な損失を大幅に抑制す ることが可能となる。また、送信用光コネクタプラグ4 1と受信用光コネクタプラグ41Aの厚みが4.4mm 20 例を示す組み立て斜視図である。 なので、光コネクタ50に確実に嵌入することができ、 確実に光通信でデータを送受信することができる。ま た、光コネクタ50が、送信用光モジュール30及び受 信用光モジュール30Aと、送信用光ファイバ40及び 受信用光ファイバ40Aを横方向、即ち、カードフレー ム11の一短辺方向に並ばせた状態で接続するので、筐 体10が厚くなるのを防止することが可能となる。さら に、複数対の挟持片52が、送信用光モジュール30と 受信用光モジュール30Aの突出してきたスリーブ32 をそれぞれ挟持するので、送信用光モジュール30や受 30 信用光モジュール30Aの位置ずれや抜けを確実に防止 することができる。

【0042】次に、図11 (a)、(b)、(c)と図 12は、本発明の他の実施例を示すもので、この場合に は、筐体10Aと光コネクタ50Aを、PPS、PE S、又は、液晶ポリマー等からなるエンジニアリングブ ラスチックで一体成形して構成するようにしている。

【0043】一体化した上記光コネクタ50Aには、図 12に示すように、送信用光モジュール30と受信用光 モジュール30Aのスリーブ32にそれぞれ貫通される 40 12…金属パネル 一対の孔54が並べて穿設されている。

【0044】また、上記成形の際、エンジニアリングプ ラスチックを使用するのは、エンジニアリングプラスチ ックは、耐熱性や高強度に優れているという理由に基づ くものである。その他の部分については上記実施例と同 様である。

【0045】本実施例においても、上記実施例と同様の 作用効果が期待でき、しかも、予め光素子34とスリー ブ32を調芯して組み立てた送信用光モジュール30と 受信用光モジュール30Aを、筐体10Aを構成するカ 50 41A…受信用光コネクタプラグ

ードフレーム11の一対の孔54に並べて挿入して固定 するので、作業工程の削減が期待できるのは明白であ る。

[0046]

【図面の簡単な説明】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、光通信実 現可能手段に光データリンクを使用することができ、こ れを通じて、光通信でデータを送受信することができ る。さらに、今後、必要となる高速光LANに使用で き、使用する場合には、著しい効果が期待できる。

【図1】本発明に係るカード型光データリンクの使用状 態を示す斜視図である。

【図2】本発明に係るカード型光データリンクの一実施 例を示す斜視図である。

【図3】本発明に係るカード型光データリンクの一実施。 例を示す断面説明図である。

【図4】本発明に係る送信用光モジュールと受信用光モ ジュールを示す断面説明図である。

【図5】本発明に係るカード型光データリンクの一実施

【図6】本発明に係るカード型光データリンクの送信用 光コネクタプラグと受信用光コネクタプラグを示す説明 図である。

【図7】本発明に係るカード型光データリンクの光コネ クタを示す断面説明図である。

【図8】本発明に係るカード型光データリンクの筐体を 示す要部説明図である。

【図9】他の送信用光コネクタプラグと受信用光コネク タブラグを示す説明図である。

【図10】本発明に係るカード型光データリンクの他の 光コネクタを示す断面説明図である。

【図11】本発明に係るカード型光データリンクの他の 実施例を示す説明図である。

【図12】本発明に係るカード型光データリンクの他の 実施例を示す断面説明図である。

【図13】従来の光データリンクを示す斜視図である。 【符号の説明】

10・10A…筐体

11…カードフレーム

13…取付孔

20…配線板

30…送信用光モジュール

30A…受信用光モジュール

32…スリーブ

37…精密スリーブ

40…送信用光ファイバ

40A…受信用光ファイバ

41…送信用光コネクタプラグ

13

42…フェルール 50・50A…光コネクタ

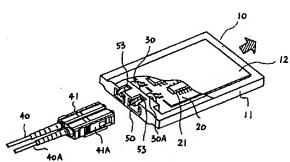
5 1 …区画板

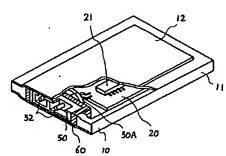
\* 5 2 …挟持片

53…切り欠き

\* 60…ブロック



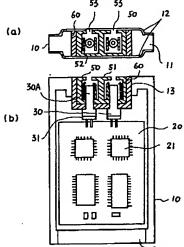


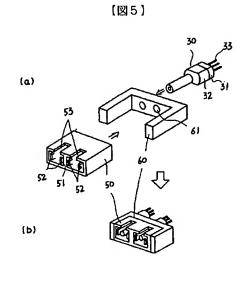


14

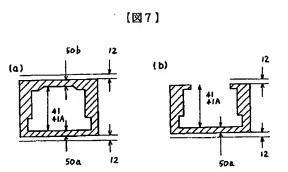
(図3) (図4)

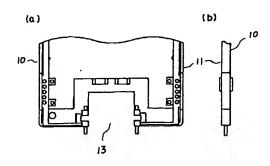
53 53 53 57 60 12 8 18

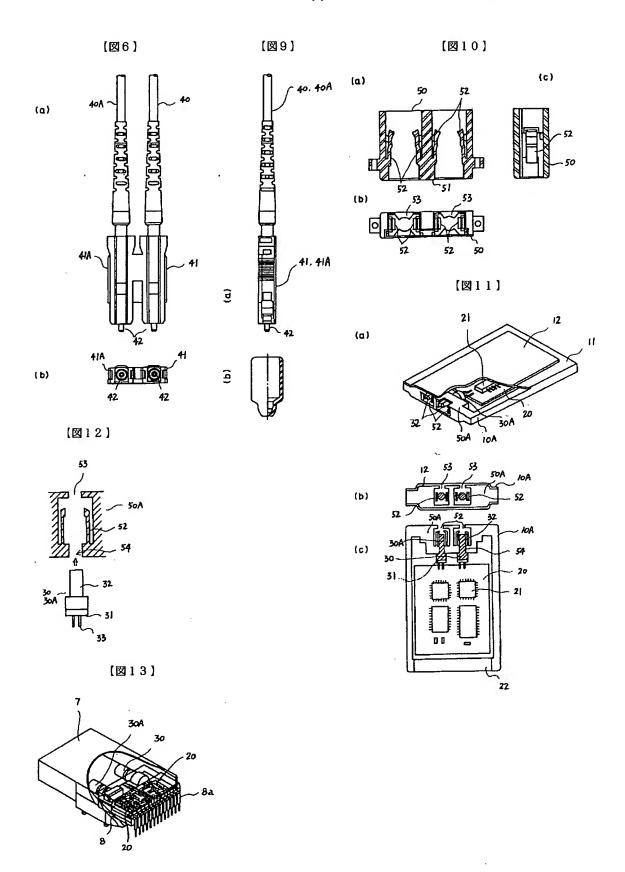




【図8】







(10)

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup> H O 4 B 10/12

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所